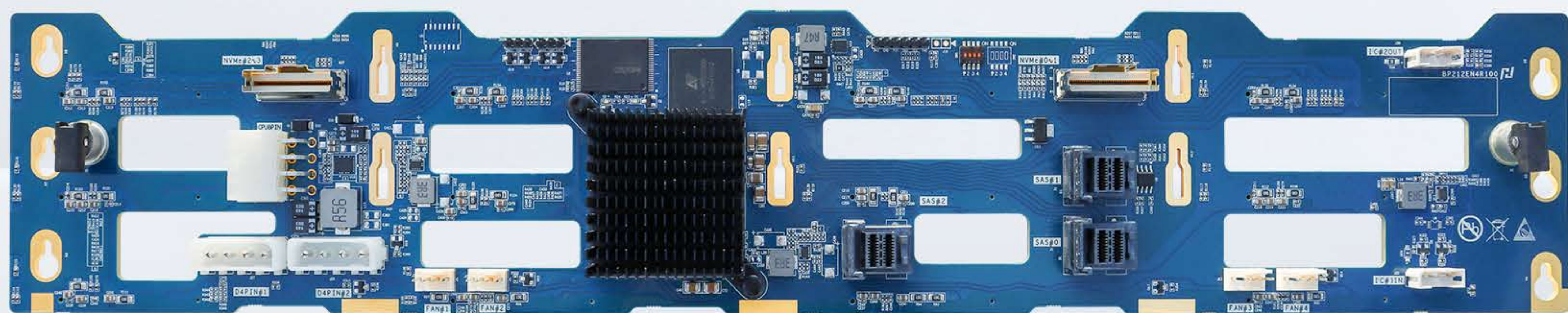


NVMe

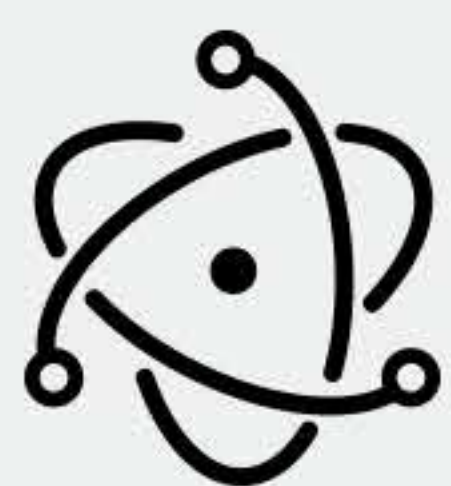
混合扩展硬盘背板



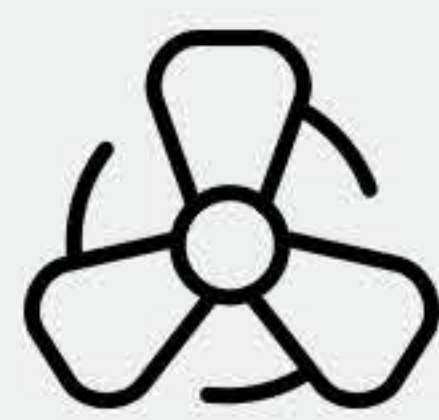
产品概述

- 2U12盘位 NVMe混合扩展硬盘背板
- 支持3.5"/2.5" NVMe/SAS/SATA硬盘，标准SFF规范设计开发
- 支持SGPIO和I²C管理信号接口，可以满足NVMe/SAS/SATA硬盘LED管理和BMC通讯
- 支持Intel&AMD全平台，风扇自动调速，固件在线升级，适配主流硬盘、线缆、板卡，布局和散热超行业标准优化
- 适合主流混闪和通用服务器、分布式系统、大数据、云服务等场景
- 覆盖互联网、电信、金融、政府、交通、院校等行业

产品特性



全平台兼容



风扇自动调速



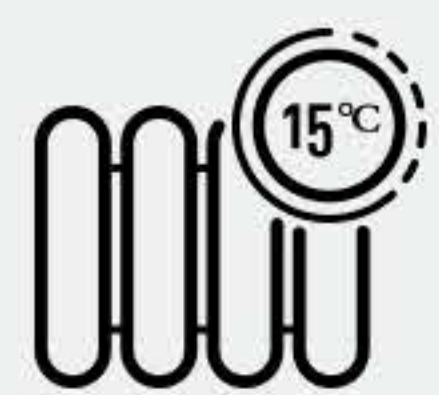
固件在线升级



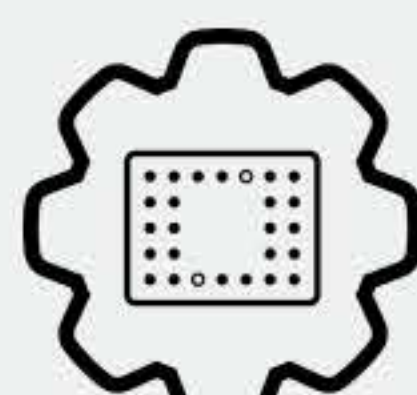
BMC兼容适配



主流兼容列表



系统散热优化



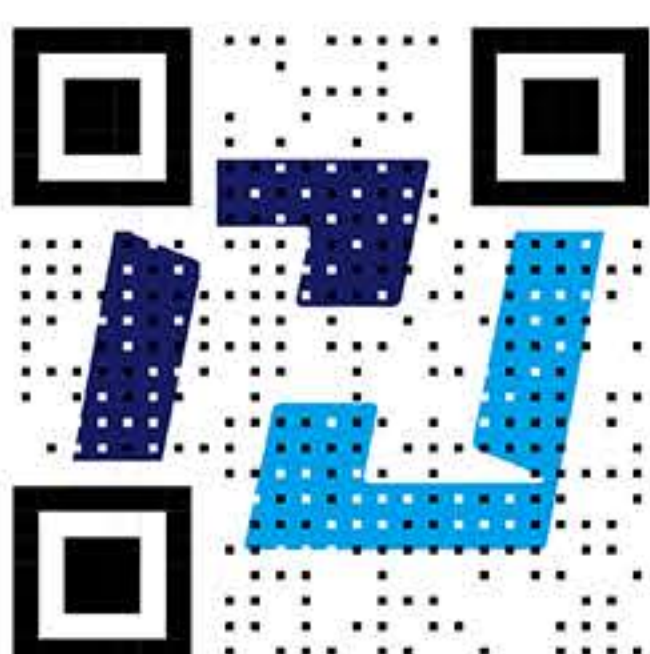
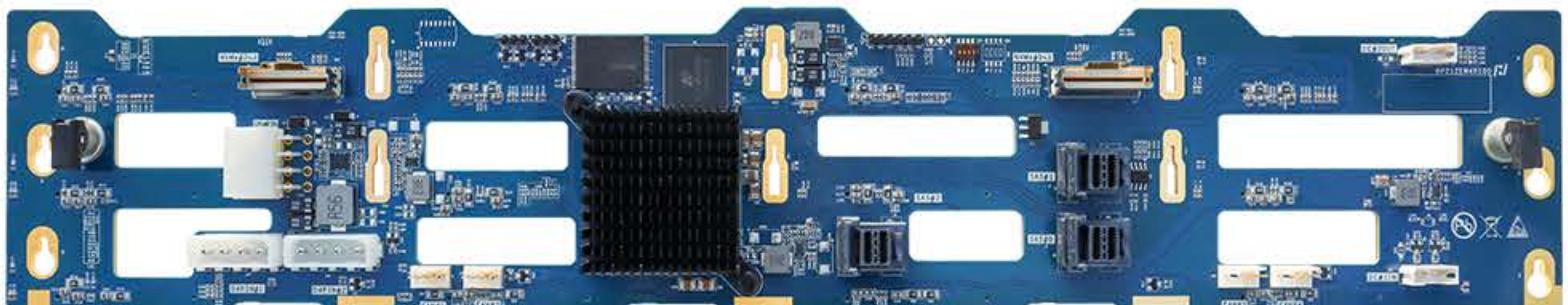
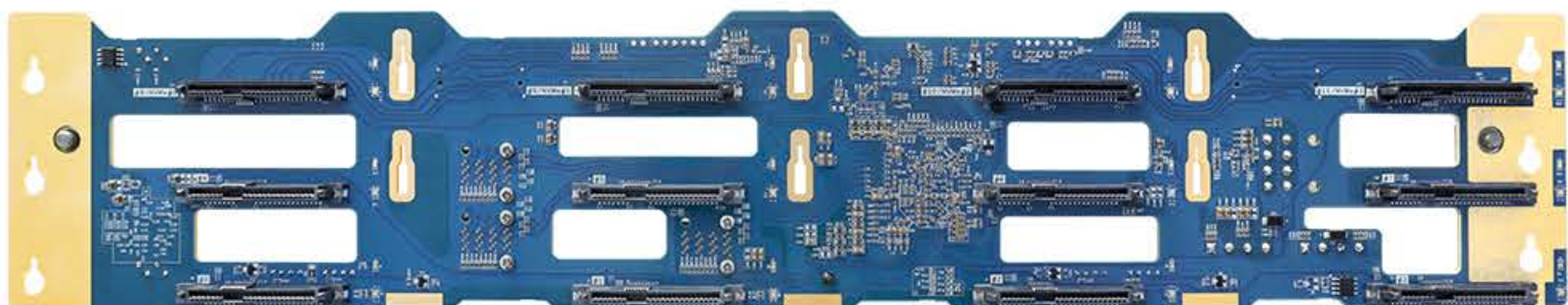
系统布局优化



BOM优化管理

技术规格

组件	描述
类型	NVMe硬盘背板
系列	NVMe混合扩展硬盘背板
规格	3.5"/2.5" 2U12
盘位	12盘位
速率	PCIe 4.0 16GT/s & SAS 3.0 12Gb/s
硬盘接口	SFF-8639*4 & SFF-8482*8
上行接口（PCIe）	Slimline x8 SFF-8654 x8*2（遵循SFF-9402 R1.1规范）
上行接口（SAS）	MiniSAS HD SFF-8643 x4*3（遵循SFF-9402 R1.1规范）
电源接口	CPU 8PIN 12V*1 / D4PIN 12V&5V*2
风扇接口	FAN4PIN风扇*4（支持监控）
管理信号	支持SGPIO（SAS/SATA硬盘LED） 支持I²C*2（NVMe U.2硬盘LED&BMC通讯）
硬盘LED	蓝灯 Power 绿红双色灯 Activity
扩展芯片	Broadcom 35x系列
通风孔面积	19.84%
重量	281.0g
产品特性	全平台兼容 主流兼容列表 风扇自动调速 系统散热优化 固件在线升级 系统布局优化 BMC兼容适配 BOM优化管理
产品编号	20220240007



华科微（北京）科技有限公司

地址：北京市海淀区唐家岭路百旺弘祥科技文化创意园3号楼2层3228

网址：www.huakewei.com.cn

固定电话：010-82825150 手机：18500365505